

ICS 25.160.40
CCS J 33



团 体 标 准

T/CWAN 0005—2021

整流器件用无铅钎料回流焊焊接推荐工艺规范

Recommended practice for reflow soldering of lead-free solder for rectifier devices

2021-06-10 发布

2021-08-01 实施

中国焊接协会 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	1
5 焊接工艺	3
6 焊接缺欠及其产生原因	4
7 焊接技术安全	4

国家标准

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国焊接协会提出并归口。

本文件起草单位：南昌航空大学、广东思泉新材料股份有限公司、重庆科技学院、新型钎焊材料与技术国家重点实验室、华北水利水电大学、上海电机学院、哈尔滨焊接研究院有限公司。

本文件主要起草人：殷祚炷、薛名山、尹立孟、张雷、任泽明、王星星、王号、王刚、刘西洋、袁锋、杨淼森、周东鹏、李敏、张鹤鹤、陈小祥、方乃文。